

PASTA PARA SOLDAR QUE NO NECESITA LIMPIEZA NC257MD

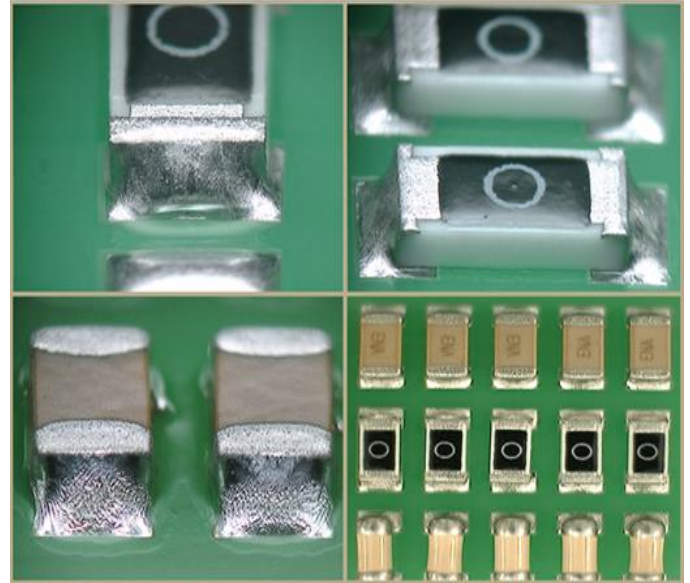
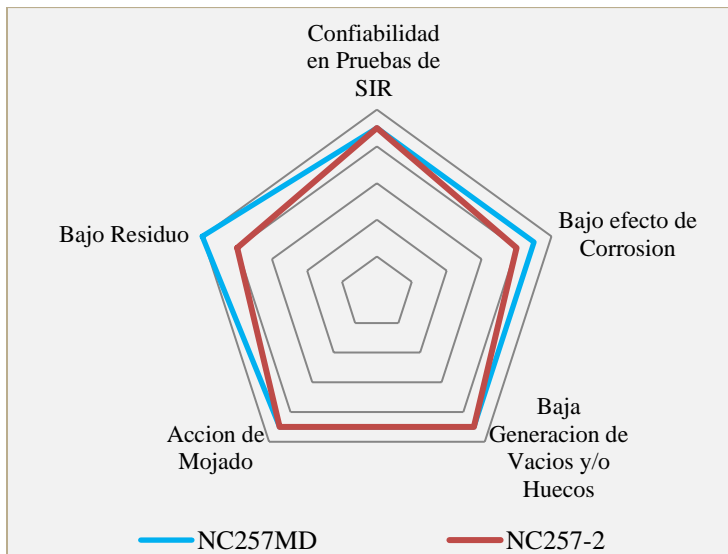
CARACTERÍSTICAS

- Diseñada Especialmente Para Equipos de Inyección Mycronic.
- Bajo Residuo de Flux y no Interfiere con las Pruebas Eléctricas.
- Excelente Acción Humectante y Mojado de Soldadura.
- Minimiza la Generación de Vacíos y/o Huecos en Micro-BGA.
- Tiempo de Retención de 8-12 Horas.
- Compatible con Procesos de Reflujo por Fase de Vapor.
- Para su uso con el eyector Mycronic AG

DESCRIPCION

La soldadura en pasta NC257MD de AIM, ha sido desarrollada específicamente para equipos de inyección Mycronic. Sus propiedades reológicas únicas fueron desarrolladas y validadas a través de extensas pruebas en colaboración con Mycronic para proporcionar depósitos continuos y consistentes. La fórmula de la soldadura en pasta NC257MD prolonga la vida de la valvula y sus componentes además de reducir la generación de desperdicio y el consumo de pasta. La excelente acción de mojado de la soldadura NC257MD genera uniones de soldadura lisas y brillantes, además minimiza la generación de vacíos y/o huecos en las uniones de dispositivos BGA's y BTC con un bajo nivel de residuo de flux después del reflujo que puede ser fácilmente removido si se requiere incluso después de procesos con elevadas temperaturas requeridas para las aleaciones libres de plomo.

CARACTERÍSTICAS



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil de la pasta refrigerada (contenedor sellado)	6 Meses	< -18°C (< 0°F)

Manejar exactamente como se indica a continuación para un mejor rendimiento. Dejar que la pasta de soldadura llegue a temperatura ambiente de forma natural antes de su uso. De < -18°C (< 0°F) - aproximadamente 12 horas. De 0°C a 12°C (32°F-55°F) - aproximadamente 4 horas. Después de abrir el contenedor, la vida útil de la pasta va a depender del entorno y de la aplicación. El reemplazo diario de la jeringa con soldadura fresca puede prolongar la vida de la valvula y sus componentes y optimizar el rendimiento. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de NC257MD para información específica del producto.

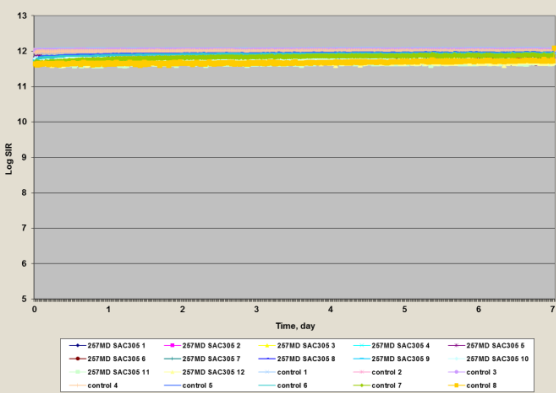
LIMPIEZA

Después del Reflujo: Los residuos de la soldadura en pasta NC257MD de AIM pueden permanecer sobre el ensamble después del reflujo y no requieren limpieza. Cuando un proceso limpio sea requerido, comuníquese con AIM para obtener mayor información sobre procesos limpios.

PERFIL DE REFLUJO

Toda la información del perfil se puede encontrar en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Póngase en contacto con AIM para obtener información adicional y/o soporte para su proceso.

DATOS DE PRUEBAS

Nombre	Método de Prueba	Resultado	
Clasificación de IPC	J-STD-004 3.2.3.1	ROL0	
Clasificación de IPC	J-STD-004B 3.3.1.2.1	ROL1	
Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Fundente.	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	
Contenido de Haluro(s) por Método de Cromatografía Iónica	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	L1	
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASS	
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	No Fluoride	
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	
Migración electroquímica	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASA	
Contenido de Sólidos No Volátiles en el Fundente.	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	86.9 Típico	
Índice de Acidez del Fundente	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	149 mg KOH/ g flux Típico	

Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Gravedad Especifica	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	3.39 Tipico	
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	500 Kcps Tipico	
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Gris, Suave, Creмосa	
Prueba colapsamiento de la Soldadura en Pasta (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Prueba de Esfera de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Prueba de retención (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	32.8 gf Tipico	
Prueba de Mojado (Wetting)	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA	